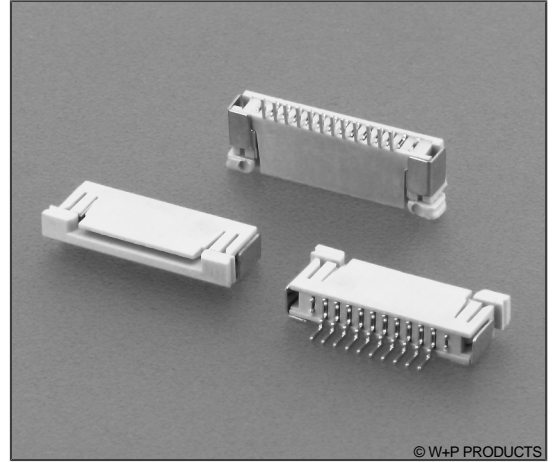


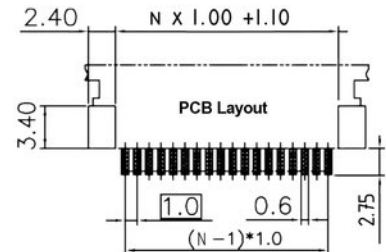
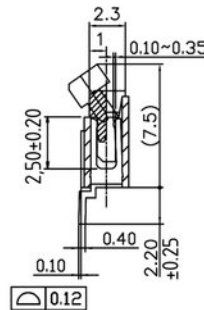
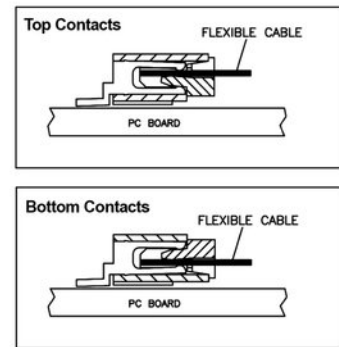
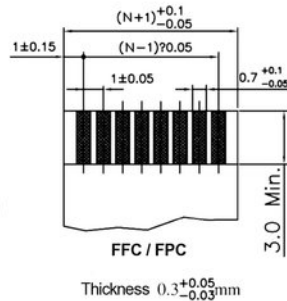
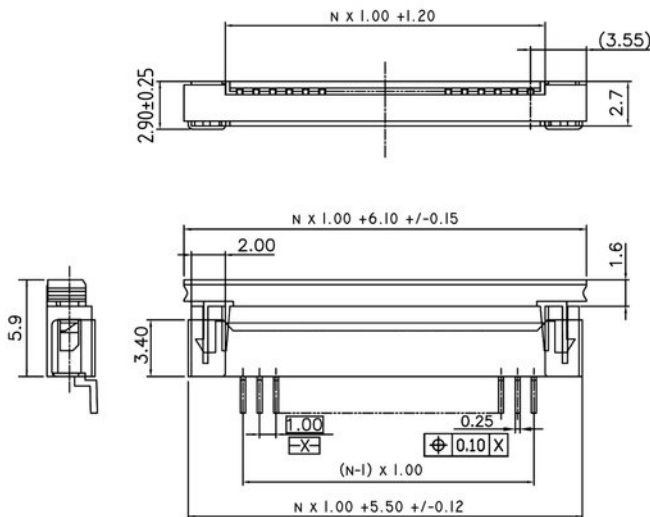
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Zinn über Nickel
<i>Contact Surface</i>	<i>Tin plated over nickel</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	300 V AC
<i>Test Voltage</i>	300 V AC
Nennspannung	60 V AC
<i>Voltage Rating</i>	60 V AC
Nennstrom	0,5 A
<i>Current Rating</i>	0,5 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	260 °C max. für 5s
<i>Processing</i>	260 °C max. for 5s



© W+P PRODUCTS

Passende Flex-Kabel:
Compatible Flexible Flat Cables:
599



Series

5532

Contacts*

10

04-30

Type*

10

10 Kontakte oben
Top contacts
20 Kontakte unten
Bottom contacts

Packaging*

ST

ST
TR (Option)

* Dies ist ein Bestellbeispiel -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
TR (Option) Tape & Reel / Tape & Reel

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

